PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-062116

(43) Date of publication of application: 29.02.2000

(51)Int.CI.

B32B 27/32 // C09J123/00

(21)Application number: 10-239235

(71)Applicant: JAPAN POLYCHEM CORP

(22)Date of filing:

25.08.1998

(72)Inventor: HASHIMOTO YOSHINORI

KONO YUJI

YAMASHITA TAKASHI

(54) LAMINATED FILM FOR PACKAGING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated film for packaging having rapid chargeability, excellent sealability and workability.

SOLUTION: The laminated film for packaging is obtained by laminating a sealant layer made of a resin composition containing a linear ethylene copolymer having a density of 0.880 to 0.910 g/cm3 and an MFR of 1 to 100 g/10 min of a copolymer of an ethylene obtained by a metallocene catalyst and α-olefin having 3 to 12 carbons, an ethylene resin having a density of 0.910 to 0.925 g/cm3 and an MFR of 1 to 100 g/10 min, and an adhesive imparting resin and/or wax component, and a base material layer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-62116 (P2000-62116A)

(43)公開日 平成12年2月29日(2000.2.29)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

デーマコート*(参考)

B32B 27/32 // C09J 123/00 103

B 3 2 B 27/32

103 4F100

C 0 9 J 123/00

4J040

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特顯平10-239235

(71)出願人 596133485

日本ポリケム株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目10番1号

(22)出顧日 平成10年8月25日(1998.8.25)

(72)発明者 橋本 美則

三重県四日市市東邦町1番地 日本ポリケ

ム株式会社四日市技術センター内

(72)発明者 河野 優二

三重県四日市市東邦町1番地 日本ポリケ

ム株式会社四日市技術センター内

(74)代理人 100106817

弁理士 鷹野 みふね

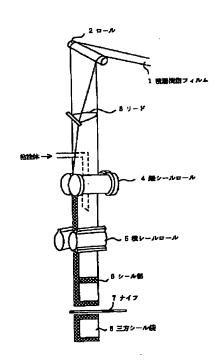
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 包装用積層フィルム

(57)【要約】

【課題】 高速充填性、シール性、及び加工性に優れた 包装用積層フィルムを提供することを課題とする。

【解決手段】 メタロセン触媒により得られるエチレンと炭素数3~12のαーオレフィンとの共重合体であって密度0.880~0.910g/сm³でMFR1~100g/10分の直鎖状エチレン系共重合体(成分A)と、密度0.910~0.925g/с㎡。でMFR1~50g/10分のエチレン系樹脂(成分B)と、粘着性付与樹脂(成分C)及び/又はワックス成分(成分D)とを含有する樹脂組成物からなるシーラント層と、基材層とを積層し、包装用積層フィルムを得る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも基材層とシーラント層とから 構成され、前記シーラント層が以下に示す成分(A)、

(B) 及び(C)を含有する樹脂組成物からなることを 特徴とする、包装用積層フィルム。

(A) メタロセン化合物を触媒としてエチレンと炭素数 $3\sim 12$ の α -オレフィンとを共重合して得られる、密 度が0.880~0.910g/cm³、MFRが1~ 100g/10分の直鎖状エチレン系共重合体:30~ 99重量%

(B) 密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂:60~0重 量%

(C)粘着性付与樹脂;10~1重量%

【請求項2】 少なくとも基材層とシーラント層とから 構成され、前記シーラント層が以下に示す成分(A)、

(B) 及び (C) を含有する樹脂組成物からなることを 特徴とする、包装用積層フィルム。

(A) メタロセン化合物を触媒としてエチレンと炭素数 3~12のα-オレフィンとを共重合して得られる、密 20 度が0.880~0.910g/cm³、MFRが1~ 100g/10分の直鎖状エチレン系共重合体;30~ 99重量%

(B)密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂;60~0重

(D) ワックス成分; 10~1重量%

【請求項3】 少なくとも基材層とシーラント層とから 構成され、前記シーラント層が以下に示す成分(A)、

(B)及び(C)を含有する樹脂組成物からなることを 30 成した。 特徴とする、包装用積層フィルム。

(A) メタロセン化合物を触媒としてエチレンと炭素数 3~12のα-オレフィンとを共重合して得られる、密 度が0.880~0.910g/cm³、MFRが1~ 100g/10分の直鎖状エチレン系共重合体:20~ 98重量%

(B) 密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂;60~0重 量%

(C) 粘着性付与樹脂; 10~1重量%

(D) ワックス成分; 10~1重量%

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、包装用積層フィル ムに関する。詳しくは、本発明は加工性、シール性、及 び高速充填性に優れた包装用積層フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、基材に必要に応じて種々の中 間層を積層させ、さらにその上にシーラント層を積層さ せて得られる積層フィルムが、包装材として使用されて 50 【0011】(A)メタロセン化合物を触媒としてエチ

きた。かかる包装材に収容される内容物は多岐にわた り、例えば液体及び粘体、並びに不溶物質として繊維、 粉体等の固形状のものを含んだ液体、粘体等がある。

【0003】とのような積層フィルムは、通常シーラン ト層においてヒートシールされる。しかしながら、シー ラント層の材質として直鎖状低密度ポリエチレンを用い た従来の積層フィルムでは、内容物の充填時にシール部 に該内容物が夾雑物としてシールされ、シール強度の低 下、異物介在による液漏れ等が発生する場合があった。

10 したがってその結果、不良率の発生が多く、また充填速 度を高くすることができず、15m/分程度が限界であ った。

【0004】また、従来のものでは、積層フィルムの製 造時にロールからのフィルムの離脱性(離ロール性)が 悪いため、加工速度が上げられず生産性が向上しないと いう問題点もあった。

【0005】よって、離ロール性が良好で加工性に優 れ、しかもシール時に内容物がシール部に夾雑シールさ れても高速充填が可能で不良率が少ない、夾雑物シール 性に優れた包装用積層フィルムの開発が望まれていた。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、髙速充填 性、シール性、及び加工性に優れた包装用積層フィルム を提供することを課題とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、このよう な状況に鑑み鋭意研究を重ねた結果、シーラント層の材 質として特定の組成を有する樹脂組成物を用いることに より、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完

【0008】すなわち、本発明は、少なくとも基材層と シーラント層とから構成され、前記シーラント層が以下 に示す成分(A)、(B)及び(C)を含有する樹脂組 成物(以下、「組成物 I」とする)からなることを特徴 とする、包装用積層フィルムを提供する。

【0009】(A)メタロセン化合物を触媒としてエチ レンと炭素数3~12のα-オレフィンとを共重合して 得られる、密度が0.880~0.910g/cm3、 MFRが1~100g/10分の直鎖状エチレン系共重 40 合体;30~99重量%

(B) 密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂:60~0重

(C) 粘着性付与樹脂; 10~1重量%

【0010】また、本発明は、少なくとも基材層とシー ラント層とから構成され、前記シーラント層が以下に示 す成分(A)、(B)及び(C)を含有する樹脂組成物 (以下、「組成物II」とする) からなることを特徴とす る包装用積層フィルムを提供する。

3

レンと炭素数3~12のα-オレフィンとを共重合して 得られる、密度が0.880~0.910g/cm³、 MFRが1~100g/10分の直鎖状エチレン系共重 合体:30~99重量%

- (B) 密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂;60~0重 量%
- (D) ワックス成分; 10~1重量%

【0012】また、本発明は、少なくとも基材層とシーラント層とから構成され、前記シーラント層が以下に示 10 す成分(A)、(B)及び(C)を含有する樹脂組成物(以下、「組成物III」とする)からなることを特徴とする包装用積層フィルムを提供する。

【0013】(A) メタロセン化合物を触媒としてエチレンと炭素数3~12のα-オレフィンとを共重合して得られる、密度が0.880~0.910g/сm³、MFRが1~100g/10分の直鎖状エチレン系共重合体;20~98重量%

(B) 密度が0.910~0.940g/cm³、MF Rが1~50g/10分のエチレン系樹脂;60~0重 20 量%

- (C) 粘着性付与樹脂; 10~1重量%
- (D) ワックス成分:10~1重量%

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。

【0014】本発明の積層フィルムは、少なくとも基材層とシーラント層とから構成されている。

【0015】(1)基材層

本発明の積層フィルムの基材層としては、包装用フィルムの基材として用いられるものであれば特に限定されず、種々のものを用いることができる。例えば、ナイロンー6、ナイロンー66等のポリアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、エチレン・酢酸ビニル共重合体の鹼化物、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニリデン等の合成樹脂、金属箔、金属蒸着フィルム、金属酸化物による蒸着フィルム等の単一基材またはこれら複合基材が挙げられる。

【0016】金属箔は、特に限定されないが、厚さ5~50μm程度のアルミニウム箔、錫箔、鉛箔、亜鉛メッキした薄層鋼板、電気分解法によりイオン化金属を薄膜にしたもの、アイアンフォイル等が用いられる。また、金属蒸着フィルムについても、特に限定されないが、蒸着金属としてはアルミニウム、亜鉛、チタン、ニッケル、鉄、モリブデン、タングステン等が、また厚みは0.01~0.2μm程度が、通常好ましく用いられる。蒸着の方法も特に限定されず、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等周知の方法が用*

*いちれる。

【0017】さらに、金属酸化物の蒸着については、一酸化ケイ素、ガラス、アルミナ、酸化マグネシウム、蛍石、酸化錫、フッ化セレン等が用いられ、これら酸化物には、微量の金属や、他の金属酸化物、金属水酸化物が含まれていてもよい。

【0018】薄膜形成は、フィルムの少なくとも片面に、上記の種々の蒸着方法を適用することによっても行うことができる。薄膜の厚みは、通常、12~40μm程度である。また、フィルムとしては特に制限はなく、延伸又は未延伸のポリエステルフィルム、ポリプロビレンフィルム、ポリアミドフィルム等の透明フィルムが挙げられる。

【0019】(2)シーラント層

本発明の積層フィルムのシーラント層は、以下に述べる 成分(A)を必須成分とし、必要に応じて成分(B)、

(C)、(D)を含む樹脂組成物からなる。

【0020】(i)成分(A)

成分(A)は、メタロセン化合物を触媒としてエチレン と炭素数 $3\sim12$ の α -オレフィンとを共重合して得ら れる直鎖状エチレン系共重合体である。

【0021】前記直鎖状エチレン系共重合体のコモノマーとして用いられる炭素数3~12のα-オレフィンとしては、プロピレン、ブテン-1、ペンテン-1、ヘキセン-1、オクテン-1、ヘプテン-1、4-メチルーペンテン-1、4-メチルーペンテン-1、4-メチルーペンテン-1、4-メチルーペキセン-1、4,4-ジメチルペンテン-1等を挙げることができる。また、コモノマーは1種類に限られず、ターボリマーのように2種類以上のα-オレフィンを用いて多元系共重合体としてもよい。特に好ましいものとしては、エチレン・ヘキセン-1共重合体、エチレン・オクテン-1共重合体等を挙げることができる。

【0022】前記直鎖状エチレン系共重合体の全構成単位中におけるエチレンと α -オレフィンとの割合は、特に限定されないが、好ましくはエチレンが72~88重量%、 α -オレフィンが12~28重量%である。なお、これらの共重合比は 13 C-NMRによって測定されたものである。

【0023】前記直鎖状エチレン系共重合体の製造に触媒として用いられるメタロセン化合物(以下、単に「メタロセン触媒」ともいう)は、具体的には、以下に示す成分a、成分b、及び必要に応じて用いられる成分cからなるものが挙げられる。

【0024】 [成分a]成分aは、下記一般式(I)で表される化合物である。

[0025]

【化1】

 $Q^{1}(C_{5}H_{4-a}R^{1}_{a})(C_{5}H_{4-b}R^{1}_{b})MeX^{1}Y^{1}\cdots(I)$

【0026】[ここで、Q¹は二つの共役五員環配位子 50 を架橋する結合性基であり、炭素数1~20の2価の炭

化水素基、炭素数1~20の炭化水素基を有するシリレ ン基、又は炭素数1~20の炭化水素基を有するゲルミ レン基を示す。Meはジルコニウム又はハフニウムを、 X¹及びY¹は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン基、 炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20のアルコ キシ基、炭素数1~20のアルキルアミド基、トリフル オロメタンスルホン酸基、炭素数1~20のリン含有炭 化水素基又は炭素数1~20のケイ素含有炭化水素基を 示す。R'及びR'は、それぞれ独立して、炭素数1~2 0の炭化水素基、ハロゲン基、アルコキシ基、ケイ素含 10 有炭化水素基、リン含有炭化水素基、窒素含有炭化水素 基又はホウ素含有炭化水素基を示す。

【0027】また、隣接する2個のR¹又はR¹がそれぞ れ結合して環を形成していても良い。a及びbは各々O $\leq a \leq 4$ 、 $0 \leq b \leq 4$ を満足する整数である。但し、R ¹及びR¹を有する2個の五員環配位子は基Q¹を介して の相対位置の観点において、Meを含む平面に関して非 対称である。]

【0028】Q¹は、上記したように、二つの共役五員 環配位子を架橋する結合性基であり、以下の(イ)、

- (ロ)及び(ハ)で示される基から選ばれる。
- (イ) 炭素数1~20、好ましくは1~6の2価の炭化 水素基、さらに詳しくは、例えばアルキレン基、シクロ アルキレン基、アリーレン等の不飽和炭化水素基、
- (ロ) 炭素数1~20、好ましくは1~12の炭化水素 基を有するシリレン基、
- (ハ) 炭素数1~20、好ましくは1~12の炭化水素 基を有するゲルミレン基。

【0029】なお、2価のQ¹基の両結合手間の距離 は、その炭素数の如何に関わらず、Q¹が鎖状の場合に 4原子程度以下、好ましくは3原子以下であることが、 Q1が環状基を有するものである場合は当該環状基+2 原子程度以下、就中当該環状基のみであることが、それ ぞれ好ましい。

【0030】従って、アルキレンの場合はエチレン及び イソプロピリデン (両結合手間の距離は2原子及び1原 子)が、シクロアルキレン基の場合はシクロヘキシレン 基 (結合手間の距離がシクロヘキシレン基のみ) が、ア ルキルシリレンの場合は、ジメチルシリレン基(結合手 間の距離が1原子)がそれぞれ好ましい。

【0031】Meは、ジルコニウム又はハフニウムであ る。X'及びY'は、それぞれ独立に、すなわち相互に同 ーでも異なっていてもよく、以下の (ニ) ~ (ル) で示 される基から選ばれる。

【0032】(ニ)水素

- (ホ) ハロゲン (フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、好まし
- (へ) 炭素数1~20、好ましくは炭素数1~12の炭 化水素基

ルコキシ基

- (チ) 炭素数1~20、好ましくは炭素数1~12のア ルキルアミド基
- (リ) 炭素数1~20、好ましくは炭素数1~12のリ ン含有炭化水素基
- (ヌ) 炭素数1~20、好ましくは炭素数1~12のケ イ素含有炭化水素基
- (ル) トリフルオロメタンスルホン酸基

【0033】また、R'及びR'は、それぞれ独立して、 炭素数1~20の炭化水素基、ハロゲン基、アルコキシ 基、ケイ素含有炭化水素基、リン含有炭化水素基、窒素 含有炭化水素基又はホウ素含有炭化水素基を示す。ま た、隣接する2個のR'又は2個のR'がそれぞれ結合し て環を形成していてもよい。a及びbはそれぞれ0≦a ≤4、0≤b≤4を満足する整数である。

【0034】具体的な例としては、特開平8-2087 33号公報に例示した化合物を挙げることができる。例 えばジメチルシリレンビス(2,4-ジメチルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス (2-メチル-4-イソプロビルインデニル)ジルコニ 20 ウムジクロリド、ジメチルシリレンピス(2-メチルー 4 – フェニルインデニル)ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレンピス(2-メチル-4,5-ベンゾイン デニル) ジルコニウムジクロリド等を挙げることができ る。これらの中でもジメチルシリレンビス(2-メチル -4,5-ベンゾインデニル)ジルコニウムジクロリ ド、又はジメチルシリレンビス(2-メチル-4-フェ ニルインデニル) ジルコニウムジクロリドを用いること が好ましい。

【0035】 [成分b] 成分bは、アルミニウムオキシ 30 化合物 (成分b-1)、ルイス酸 (成分b-2)、及 び、成分aと反応して成分aをカチオンに変換すること が可能なイオン性化合物(成分b-3)のうちから選ば れる化合物である。

【0036】ととで、ルイス酸のあるものは、「成分a と反応して成分aをカチオンに変換することが可能なイ オン性化合物」として捉えることができる。従って、

「ルイス酸」及び「成分aと反応して成分aをカチオン に変換することが可能なイオン性化合物」の両者に属す る化合物は、いずれか一方に属するものと解釈するもの とする。

【0037】成分b-1、成分b-2、成分b-3につ いての具体的な化合物や製造法については、特開平6-239914号公報及び特開平8-208733号公報 に例示された化合物や製造法を挙げることができる。

【0038】例えば、成分b-1としては、1種類のト リアルキルアルミニウムと水から得られるメチルアルモ キサン、エチルアルモキサン、ブチルアルモキサン、イ ソブチルアルモキサン、2種類のトリアルキルアルミニ (ト) 炭素数 $1\sim20$ 、好ましくは炭素数 $1\sim12$ のア 50 ウムと水から得られるメチルエチルアルモキサン、メチ

ルブチルアルモキサン、メチルイソブチルアルモキサ ン、また、アルキルボロン酸としては、メチルボロン 酸、エチルボロン酸、ブチルボロン酸、イソブチルボロ ン酸等を挙げることができる。

【0039】また、成分b-3としては、トリフェニル カルボニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボ レート、さらに成分b-2としては、トリフェニルホウ 素、トリス(3,5-ジフルオロフェニル)ホウ素、ト リス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N. N-ジ メチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニ 10 ル) ボレートを用いることが好ましい。

【0040】 [成分c] 成分cは有機アルミニウム化合 物であり、必要に応じて用いられる。好ましいものとし ては、下記一般式 (II) で表される化合物が挙げられ、 これらの化合物は単独で又は複数種を組み合わせて使用 することができる。

[0041]

[$\{\xi Z\}$] (AlR⁴, X_{3-n}), ···(II)

【0042】[式中、R'は 炭素数1~20、好まし くは1~10のアルキル基を示し、Xはハロゲン、水 素、アルコキシ基、又はアミノ基を示す。nは1~3、 好ましくは2~3の整数、mは1~2、好ましくは1で

【0043】具体的な化合物としては、トリメチルアル ミニウム、トリエチルアルミニウム、トリノルマルプロ ピルアルミニウム、トリノルマルブチルアルミニウム、 トリイソブチルアルミニウム、トリノルマルヘキシルア ルミニウム、トリノルマルオクチルアルミニウム、トリ ノルマルデシルアルミニウム、ジエチルアルミニウムモ ノクロライド、エチルアルミニウムセスキクロライド、 ジエチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウム エトキシド、ジエチルアルミニウムジメチルアミド、ジ イソブチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルアルミ ニウムクロライド等を挙げることができる。これらの中 で、好ましくは、m=1、n=3のトリアルキルアルミ ニウム及びジアルキルアルミニウムヒドリドである。さ らに好ましくは、R'が炭素数1~8であるトリアルキ ルアルミニウムである。

【0044】 [触媒の調製] 本発明の直鎖状エチレン系 共重合体の製造に用いられるメタロセン触媒は、前記成 40 分a、成分b及び必要に応じて用いられる成分cを、重 合槽内であるいは重合槽外で、重合させるべきモノマー の存在下あるいは不存在下に接触させることにより調製 するととができる。

【0045】上記メタロセン触媒は微粒子状の固体を担 体として用い、固体状触媒として使用することも可能で ある。微粒子状の固体としては、無機化合物としてはシ リカ、アルミナ等の無機の多孔質酸化物、有機化合物と してはエチレン、プロピレン、1-ブテン等のα-オレ フィン、又はスチレンを主成分として生成される重合体 50 しくは $0\sim60~k~g/c~m^3\cdot G$ 、特に好ましくは $1\sim$

もしくは共重合体等を挙げることができる。

【0046】上記メタロセン触媒は、オレフィンの存在 下で予備重合を行ったものであってもよい。予備重合に 用いられるオレフィンとしては、エチレン、プロピレ ン、1-プテン、3-メチル-プテン-1、スチレン、 ジビニルベンゼン等が用いられるが、これらと他のオレ フィンの混合物であってもよい。

【0047】上記メタロセン触媒の調製において使用さ れる成分a、成分b、成分cの割合は任意であるが、一 般的に成分りとして何を選択するかで好ましい使用量の 範囲が異なる。

【0048】成分bとして成分b-1を使用する場合、 成分b-1のアルミニウムオキシ化合物中のアルミニウ ム原子と成分a中の遷移金属の原子比(A 1/Me)は 1~100000、さらに10~10000、特に50 ~5000の範囲内とするのが好ましい。

【0049】成分bとして成分b-2のルイス酸や成分 b-3のイオン性化合物を使用する場合は、成分a中の 遷移金属と成分b-2又は成分b-3のモル比が0.1 20 ~1000、さらに0.5~100、特に1~50の範 囲で使用するのが好ましい。

【0050】成分cの有機アルミニウム化合物を使用す る場合は、その使用量は、成分aに対するモル比で10 *以下、さらに10*以下、特に10*以下の範囲とする のが好ましい。

【0051】 [重合] 上記メタロセン触媒を用いた直鎖 状エチレン系共重合体の製造は、該触媒の存在下にエチ レンと炭素数3~12のα-オレフィンとを混合接触さ せることにより行われる。反応系中の各モノマーの量比 は経時的に一定である必要はなく、各モノマーを一定の 30 混合比で供給することも便利であるし、供給するモノマ ーの混合比を経時的に変化させることも可能である。ま た、共重合反応比を考慮してモノマーのいずれかを分割 添加することもできる。

【0052】重合様式は、触媒成分と各モノマーが効率 よく接触する方法であれば、あらゆる様式を採用すると とができる。具体的には、不活性溶媒を用いるスラリー 法、バルク法、溶液重合法あるいは実質的に液体溶媒を 用いず各モノマーをガス状に保つ気相法等を採用するこ とができる。

【0053】また、連続重合、回分式重合にも適用され る。スラリー重合の場合には、重合溶媒としてヘキサ ン、ヘプタン、ペンタン、シクロヘキサン、ベンゼン、 トルエン等の飽和脂肪族又は芳香族炭化水素の単独ある いは混合物を用いることができる。

【0054】重合時条件としては重合温度が−78℃~ 160℃、好ましくは0℃~150℃であり、そのとき の分子量調節剤として補助的に水素を用いることができ る。また、重合圧力は0~90kg/cm²·G、好ま

50kg/cm'・Gが適当である。

【0055】とのようにして得られる本発明の直鎖状エ チレン系共重合体の密度は0.880~0.910g/ cm³、好ましくは0.880~0.900g/cm³で ある。密度が上記範囲未満ではブロッキング性の点で好 ましくない。また、密度が上記範囲を超えると夾雑物シ ール性の点で好ましくない。

【0056】また、前記直鎖状エチレン系共重合体のM FR (メルトフローレート;溶融流量)は1~100g /10分、好ましくは5~50g/10分である。MF Rが上記範囲未満では押出時にモーターの負荷がかかり すぎるので好ましくない。また、MFRが上記範囲を超 えると加工時のネックインが大きくなるので好ましくな い。なお、この場合のMFRはJIS-K7210(1 90℃、2.16kg荷重) に準拠して測定した値であ

【0057】(ii)成分(B)

本発明の成分(B)はエチレン系樹脂であり、その密度 は0.910~0.940g/cm'、好ましくは0. 911~0.921g/c m³である。密度が上記範囲 を超えるとシール性の点で好ましくない。

【0058】また、前記エチレン系樹脂のMFRは1~ 50g/10分、好ましくは1~10g/10分であ る。MFRが上記範囲未満では押出時にモーターの負荷 がかかりすぎるので好ましくない。また、MFRが上記 範囲を超えると加工時のネックインが大きくなるので好 ましくない。なお、このMFRは成分(A)の場合と同 様に、JIS-K7210 (190℃、2. 16kg荷 重)に準拠して測定した値である。

【0059】とのようなエチレン系樹脂としては、高圧 30 法低密度ポリエチレン、直鎖状低密度エチレン共重合 体、エチレン・酢酸ビニル共重合体等が挙げられる。

【0060】(iii)成分(C)

本発明の成分(C)は、粘着性付与樹脂である。粘着性 付与樹脂とは、樹脂組成物に粘着性(接着性)を付与し 得る樹脂一般をいう。本発明で用いられる粘着性付与樹 脂としては、ロジン系、テルベン系、石油樹脂系、クロ マン樹脂系のもの等が挙げられる。

【0061】ロジン系の粘着性付与樹脂としては、ガム ロジン、ウッドロジン、重合ロジン、不均化ロジン、水 40 添ロジン、二量化ロジン等が挙げられ、さらにこれら各 種ロジンとペンタエリスリトール、グリセリン、ジエチ レングリコール等とのエステル、ロジンフェノール樹脂 なども例示される。

【0062】テルベン系の粘着性付与樹脂としては、テ ルペン樹脂、テルペンとスチレンとの共重合体、テルペ ンとα-メチルスチレンとの共重合体、テルペンとフェ ノールとの共重合体及びこれらの水添物などが例示され る。

【0063】石油樹脂系の粘着性付与樹脂としては、脂 50 本発明で用いられる樹脂組成物としては、成分(A)、

肪族石油樹脂(イソブチレン、ブタジエン、1,3-ペ ンタジェン、イソプレン、ピペリジンなどのC。~C。そ ノ又はジオレフィンを主成分とする重合体等)、脂環族 石油樹脂(スペントC、~C、留分中のジェン成分を環化 2 量体化後重合させた樹脂、芳香族系炭化水素樹脂を核 内水添した樹脂等)、芳香族石油樹脂(ピニルトルエ ン、インデン、αーメチルスチレンなどのC。~C1。の ビニル芳香族炭化水素を主成分とした樹脂等)、脂肪族 - 芳香族共重合体等の石油樹脂及びこれらの水添物など 10 が例示される。

【0064】クロマン樹脂系の粘着性付与樹脂として は、クロマン樹脂、クロマンーインデン樹脂等が挙げら れる。また、上記以外に、キシレン樹脂、スチレン系樹 脂等も粘着性付与樹脂として使用することができる。 【0065】上記粘着性付与樹脂は各々単独で用いても 良く、また種類や軟化点の異なるものを2種以上併用し てもよい。これらの粘着性付与樹脂は、液状ロジン樹 脂、液状テルベン樹脂等の液状の粘着樹脂であってもよ い。さらに、上記粘着性付与樹脂は無水マレイン酸、マ 20 レイン酸エステルなどでグラフト変性したものであって もよい。

【0066】上記粘着性付与樹脂としては、環球法軟化 点 (測定法: JAI-7-1991に準拠) が30~1 60℃のものが好ましく、より好ましくは環球法軟化点 が60~140℃のものである。また、常温で液状のも のは単独で使用すると接着剤の凝集力を低くしすぎる場 合があるが、常温で固形のものと併用することにより使 用することができる。

[0067] (iv) 成分(D)

本発明の成分(D)は、ワックス成分である。ワックス 成分としては、例えば、パラフィンワックス、マイクロ クリスタリンワックス、フィッシャートロプシュワック ス、ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス、 及びこれらを酸化分解して得られる酸化ワックス、並び に前記ワックス類にマレイン酸、無水マレイン酸、フマ ル酸、アクリル酸、メタクリル酸等の不飽和(無水)カ ルボン酸をグラフトした酸変性ワックスなどが挙げられ る。上記各種ワックス成分は、各々単独で用いても良 く、また種類等の異なるものを2種以上併用してもよ

【0068】なお、極性基含有ワックスを用いる場合 は、上記粘着性付与樹脂又は上記ワックス成分のうち極 性基を含まないものと混合して用いるのが好ましい。そ の場合、その混合比は、粘着性付与樹脂又は極性基を含 まないワックス成分に対する重量比で50重量%以下で あることが好ましい。混合比が50重量%より多いと、 樹脂組成物としたときに熱安定性や接着強度が低下する 傾向にあるので好ましくない。

【0069】(v)樹脂組成物

(B)、及び(C)からなる組成物 I、成分(A)、

11

(B)、及び(D)からなる組成物II、成分(A)、

(B)、(C)及び(D)からなる組成物IIIがある。

[0070]組成物 I:本発明の組成物 Iは、上記成分(A)を30~99重量%、好ましくは55~94重量%含有し、成分(B)を60~0重量%、好ましくは40~5重量%含有し、成分(C)を10~1重量%、好ましくは5~1重量%含有するものである。

【0071】成分(A)の含有量が30重量%未満では、シール性の点で好ましくなく、99重量%を超える 10と加工性の点で好ましくない。成分(B)は任意成分であり、樹脂組成物に必ずしも含まれていなくてもよいが、該成分(B)を配合することによって加工性が向上し、特にネックインが小さくなるという利点が得られる。一方、この含有量が60重量%を超えるとシール性の点で好ましくない。

【0072】成分(C)である粘着性付与樹脂の含有量は、10重量%を超えると樹脂組成物全体の溶融粘度が小さくなり、押出ラミネート成形における加工性が悪化し、さらに樹脂組成物中の熱安定性、耐ブロッキング性 20が悪化したり、袋での耐圧強度が低くなるので好ましくない。また1重量%より少ないと夾雑物シール性の点から好ましくない。

[0073]組成物II:本発明の組成物IIは、上記成分 (A)を $30\sim99$ 重量%、好ましくは $55\sim94$ 重量%含有し、成分 (B)を $60\sim0$ 重量%、好ましくは $40\sim5$ 重量%含有し、成分 (D)を $10\sim1$ 重量%、好ましくは $5\sim1$ 重量%含有するものである。

【0074】成分(A)の含有量が30重量%未満では、シール性の点で好ましくなく、99重量%を超える 30と加工性の点で好ましくない。成分(B)は組成物 Iの場合と同様に任意成分であるが、該成分(B)を配合することによって加工性が向上し、特にネックインが小さくなるという利点が得られる。一方、この含有量が60重量%を超えるとシール性の点で好ましくない。

【0075】成分(D)であるワックス成分の含有量は、10重量%を超えると、樹脂組成物全体の溶融粘度が小さくなり、押出ラミネート成形における加工性が悪化し、さらに樹脂組成物中の熱安定性、耐ブロッキング性が悪化したり、袋での耐圧強度が低くなるので好ましくない。また1重量%より少ないと夾雑物シール性の点から好ましくない。

と加工性の点で好ましくない。成分(B)は任意成分であるが、該成分(B)を配合することによって加工性が向上し、特にネックインが小さくなるという利点が得られる。一方、この含有量が60重量%を超えるとシール性の点で好ましくない。

【0078】成分(C)及び成分(D)の含有量は、各々10重量%を超えると樹脂組成物全体の溶融粘度が小さくなり、押出ラミネート成形における加工性が悪化し、さらに樹脂組成物中の熱安定性、耐ブロッキング性が悪化したり、袋の耐圧強度が低下するので好ましくない。また1重量%より少ないと夾雑物シール性の点から好ましくない。

【0079】その他の添加成分:本発明の樹脂組成物(組成物 I ~ III)には、上記成分(A)~ (D)に加え、本発明の効果を著しく損なわない範囲において、通常用いられる樹脂添加剤等を付加的成分として添加するとかできる。該付加的成分としては、通常のポリオレフィン樹脂用配合剤として使用される核剤、フェノール系酸化防止剤、リン系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤、中和剤、光安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤、中和剤、光安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤、金属不活性剤、充填剤、抗菌防黴剤、蛍光増白剤等をが挙げることができる。これらの付加的成分の配合量は、樹脂組成物全体に対し、一般に0.001~1重量%、より好ましくは0.01~0.5重量%である。

【0080】(vi)樹脂組成物の調製 大み四つ田いてわる横彫組成物の調製

本発明で用いられる樹脂組成物(組成物 I ~III)は、通常、上記成分(A)~(D)のうちの必要な成分に、さらに他の付加的成分を必要に応じて配合し、混合、溶融、混練することにより製造することができる。

【0081】混合、溶融、混糠は、通常、ヘンシェルミキサー、スーパーミキサー、Vーブレンダー、タンブラーミキサー、リボンブレンダー、バンバリーミキサー、ニーダーブレンダー、一軸又は二軸の混糠押出機等にて実施することができる、これらの中でも一軸又は二軸の混練押出機により混合或いは溶融混練を行うことが好ましい。

【0082】(3)中間層

本発明の積層フィルムには、上述した基材層とシーラント層との間に、さらに必要に応じて種々の中間層を設けることができる。中間層の材質としては、エチレン・αーオレフィン共重合体、高圧法低密度ポリエチレン等を挙げることができる。

【0083】またそのほかに、積層フィルムに各種の機能を付与するために通常設けられる種々の層を必要に応じて設けることができる。これらの例としては、接着層、ガスバリヤー層等を挙げることができる。

【0084】(4)積層フィルム

本発明の積層フィルムは、上記基材層及びシーラント層並びに必要に応じて設けられる中間層を構成層として有せる

【0085】積層フィルム全体の厚み及び各層の厚み並びに厚み比については特に制限はなく、内容物や用途等に応じて適宜決定すればよいが、具体的には、積層フィルム全体の厚みは $40\sim120\mu$ m、基材層の厚みは $10\sim40\mu$ m程度が好ましい。中間層を設ける場合は、該中間層の厚みは $20\sim40\mu$ m程度が好ましい。

[0086] 積層フィルムの製造方法については特に制 に、基材 (A) が下側になるように積層フィルム1をガ 限はなく、例えば従来の多層フィルムの成形方法に従っ イドロール2に供給し、リード3により積層フィルム1 を二つ折りした。この二つ折りした積層フィルム間に内 後それらを接着させて積層する方法、押出法によって各 層の形成および積層を同一工程で行う方法等が挙げられ スルムの左端の縦方向をヒートシールした。次いで、横 シールした後、内容物を一定量充填されたら横シールロ

【0087】各層を別個にフィルム状に形成した後接着させる方法の場合、フィルムの製造は、空冷インフレーション成形法、空冷2段冷却インフレーション成形法、Tダイフィルム成形法、水冷インフレーション成形法等を採用することができる。

【0088】また、押出法の場合は、押出ラミネート法、ドライラミネート法、サンドイッチラミネート法、共押出法(接着層を設けない共押出、接着層を設ける共押出、接着樹脂を配合する共押出等を含む)等の方法がある。

【0089】また、積層の際は、フィルム表面の接着性をよくするために、予め基材上にコロナ放電処理、オゾン処理、フレーム処理等の表面処理を行うことができる。さらに、接着性増強等のために、予め基材上にアンカーコート剤を塗布してから積層するのが好ましい。アンカーコート剤としては、イソシアネート系、ポリエチレンイミン系、ポリブタジェン系等のものが挙げられる

【0090】このようにして得られる本発明の積層フィルムは、種々の包装材、例えば食品包装材、医療用包装材、エンジンオイルなどの工業材料包装材等として用いることができる。特に、繊維、粉体等の固形状の不溶物を含む液体、粘体等の流体を内容物として収容するための包装材として好適に用いられる。

[0091]

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例にのみ限定されるも 40 のではない。なお、以下の実施例及び比較例における各物性の測定及び評価は以下に示す方法によって実施した。

【0092】(1) MFRの測定

JIS-K7210 (190℃、2.16kg荷重) に 準拠して測定した。

【0093】(2)積層フィルムの加工性評価 積層フィルム成形時の加工性を、以下の基準で離ロール 性を判定するととにより評価した。

〇:離ロール性が良好。

△:離ロール性が若干悪い。

×:離ロール性が悪く、加工速度が上げられず生産に支障を与える。

【0094】(3)積層フィルムへの充填方法

図1に示す公知のダイロール方式の自動充填包装機を用いて、積層フィルムより三方シール袋を形成した。すなわち、積層フィルム1のシーラント層(C)側を上側に、基材(A)が下側になるように積層フィルム1をガイドロール2に供給し、リード3により積層フィルム1をガイドロール2に供給し、リード3により積層フィルム1をがを元填し、縦シールロール4で二つ折りした積層フィルムの左端の縦方向をヒートシールした。次いで、横シールした後、内容物を一定量充填された6横シールロール5で横方向にヒートシールし、前記横方向のヒートシール部6をナイフ7でカッティングし、内容物が充填された三方シール袋8を製造した。

【0095】(4)充填速度及びシール性の評価 粘性体自動充填包装機(小松製作所製、MODEL・K MW313)を用いて、次の条件で粘性体を充填し、充 20 填速度、袋の耐圧強度、及び経時液漏れ性を評価した。 【0096】[充填条件]

シール温度:(縦)210℃、(横)1;160℃、

2;160℃

包装形態:三方シール

袋寸法: (内寸) 縦47mm×横24mm、(外寸) 縦60mm×横32.5mm

充填物: おろししょうが(長繊維入り)

充填量:約6cc

【0097】[最高充填速度の判定基準]種々の充填速 30 度で充填を行い、充填後の袋の特に縦シール部におい て、以下に示す不具合の少なくともいずれかが発生した ときの充填速度を、その積層フィルムの最高充填速度と

(a) シワ及び気泡がある。

- (b) 一部剥離 (シール不良) がある。
- (c)波がある。
- (d)液漏れがある。

【0098】[耐圧強度の判定基準]前記基準で決定された最高充填速度で充填した袋を、耐圧テスター(小松製作所製)にて100kg荷重で3分間保持し、以下に示す3段階で評価した。

○:液漏れ、破袋、及びシール部剥離なし。

△;シール部剥離発生。

×;液漏れ、破袋あり。

【0099】[経時液漏れ性の判定基準]最高充填速度で充填した袋を500個作成した袋をポリエチレン袋に入れ、ヒートシールにて密閉し3日間放置した後、開封して液漏れ袋の個数を計測し、経時による液漏れを評価した。

50 [0100]

14

【実施例1】厚さ15μmの二軸延伸ナイロンフィルム (ONY) 基材に、イソシアネート系アンカーコート剤 (日本曹達(株)製、チタボンドT-120)溶液を塗 布し、温度80℃で3秒間乾燥した面に、共押出ラミネ ーターのTダイから、以下に示す中間層とシーラント層 とを共押出し、基材層/中間層/シーラント層の3層か らなる積層フィルムを成形した。

【0101】(中間層)触媒としてメタロセン化合物を 用いて得られたエチレン・ヘキセン-1共重合体(日本 ーネルは登録商標)。MFR;11g/10分、密度; 0.920g/cm')を樹脂温度290℃、幅560 mm、厚み30μmとなるように押出した。

【0102】(シーラント層)以下に示す成分(A)、 (B) 及び(C) の混合物を二軸押出機にて溶融混練 し、ペレット化して樹脂組成物を得た。得られた樹脂組 成物を樹脂温度280℃、幅560mm、厚み15μm

となるように押出した。

【0103】(A)直鎖状エチレン系共重合体として、 メタロセン触媒を用いて得られたエチレン・ブテン-1 20 共重合体 (MFR; 32g/10分、密度; 0.88g /cm'、ブテン含量;23重量%):75重量%

(B) エチレン系樹脂として、低密度ポリエチレン「ノ バテックLC600A」(日本ポリケム(株)製、MF R;7g/10分、密度;0.919g/cm³、ノバ テックは登録商標):20重量%

(C) 粘着性付与樹脂として、水添テルペン樹脂である 商品名「クリアロンP-125」(ヤスハラケミカル (株) 製、GPC法による分子量;700):5重量% 【0104】なお、この成形におけるエアーギャップは 30 120mmで、ラミネート速度は100m/分とした。 また、共押出溶融膜の基材面側にはオゾン処理を行っ た。さらに成形後12時間以内に、温度40℃、湿度1 0%以下の乾燥機中に24時間保管し、これをエージン グ処理として目的の積層フィルムを得た。

[0105]

【比較例1】実施例1において、シーラント層を構成す る樹脂組成物を、以下に示す成分(A)と(B)との混 合物を用いて調製した他は、実施例1と同様にして積層 フィルムを得た。

【0106】(A)メタロセン触媒を用いて得られたエ チレン・ブテン-1共重合体 (MFR:32g/10 分、密度; 0. 88g/cm³、ブテン含量; 23重量 %):80重量%

(B) 低密度ポリエチレン「ノバテックLC600A」

(日本ポリケム (株) 製、MFR; 7g/10分、密 度; 0. 919g/cm³):20重量% [0107]

16

【実施例2】実施例1において、シーラント層を構成す る樹脂組成物を、以下に示す成分(A)、(B)及び (D) の混合物を用いて調製した他は、実施例1と同様 にして積層フィルムを得た。

【0108】(A) メタロセン触媒を用いて得られたエ チレン・ブテン-1共重合体 (MFR:32g/10 ポリケム (株) 製、商品名「カーネルKC581」 (カ 10 分、密度; 0.88g/cm³、ブテン含量; 23重量 %):75重量%

> (B) 低密度ポリエチレン「ノバテックLC600A」 (日本ポリケム (株) 製、MFR;7g/10分、密 度; 0. 919g/cm³):20重量%

(D) ワックス成分として、低分子量ポリエチレンであ る商品名「サンワックス165」(三洋化成工業(株) 製、GPC法による分子量;5000):5重量% [0109]

【実施例3】実施例1において、シーラント層を構成す る樹脂組成物を、以下に示す成分(A)、(B)、

(C)及び(D)の混合物を用いて調製した他は、実施 例1と同様にして積層フィルムを得た。

【0110】(A) メタロセン触媒を用いて得られたエ チレン・ブテン-1共重合体 (MFR:32g/10 分、密度; 0. 88g/cm³、ブテン含量; 23重量 %):70重量%

(B) 低密度ポリエチレン「ノバテックLC600A」 (日本ポリケム (株) 製、MFR: 7g/10分、密 度; 0. 919g/cm3):20重量%

(C) 水添テルペン樹脂「クリアロンP-125」(ヤ スハラケミカル(株)製、粘着性付与樹脂):5重量% (D) ワックス成分「サンワックス165」(三洋化成 工業(株)製):5重量%

[0111]

【実施例4】実施例3において、成分(D)のワックス 成分として、商品名「ユーメックス2000」(三洋化 成工業(株)製、マレイン酸変性ポリエチレン(変性度 5%))5重量%に変更した他は、実施例3と全く同様 にして積層フィルムを得た。

[0112]

【比較例2】実施例1において、(A)成分量を55重 量%、(C)成分量を25重量%に変更した他は、実施 例1と全く同様にして積層フィルムを得た。

[0113]

【表1】

表1

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2
成 分	(A) (B) (C) (D)	7 6 2 0 5 —	7 5 2 0 - 5	7 0 2 0 5 6	7 0 2 0 5 5	8 0 2 0 - -	5 5 2 0 2 5 —
加工性	離ロール性	0	0	0	0	0	×
品質	最高充填速度 耐圧強度 液 漏 れ	2 5 O 0	2 5 O 0	2 5 O 0	2 5 O O	1 5 O 1 0	20 Δ 30

[0114]

【発明の効果】本発明の積層フィルムは、離ロール性が良好で加工性に優れている。また、本発明のシーラント層を用いれば、シール時に内容物がシール部に夾雑シールされても漏れのないようシールされるため、高速充填が可能で不良率が少ない。よって、特に繊維、粉体等の固形状の不溶物を含む液体、粘体等の流体を内容物とする包装材として好適に用いられる。

【図面の簡単な説明】

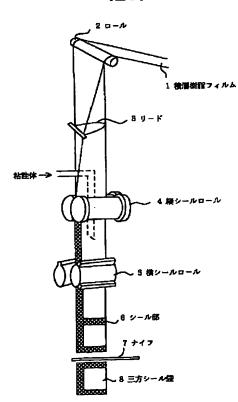
【図1】ダイロール方式の自動充填包装機を用いて三方 ヒートシール袋を製造する工程を示すフローシート図で*

∗ある。

【符号の説明】

- 1. 積層樹脂フィルム
- 2. ロール
- 3. リード
- 4. 縦シールロール
- 5. 横シールロール
- 6. シール部
- 20 7. ナイフ
 - 8. 三方シール袋

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 山下 隆

三重県四日市市東邦町1番地 日本ポリケム株式会社四日市技術センター内

Fターム(参考) 4F100 AJ01 AJ11B AK01B AK04B

AK06 AK48 AK51G AK62B AK63B AK65 AL05B AT00A BA02 BA15 BA28 CB01 EC18B GB15 JA06B JA13B JL00

JL01 JL11 YY00B

4J040 BA182 BA202 DA021 DA022

DA031 DA032 DA041 DA042

DA051 DA052 DA121 DA122

DE031 DE032 DK012 DN032

DN072 EL012 KA26 LA04

LA06 LA08 LA11 MA02 MA10

MA11 MB03 NA06 NA08



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
T OWNER

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.